科技與通訊產業(TC)

硬體(TC-HW)

1.產品安全

1.1 辨認及因應產品資料安全風險之作法之描述	1. 識別產品中資訊系統漏洞（Vulnerabilities）的方法。 本公司產品為封閉式系統醫療顯示器，不具備連網功能，故主要針對韌體與供應鏈風險進行識別： 源碼檢測與韌體驗證： 在產品開發階段，針對顯示器控制晶片之韌體（Firmware）進行原始碼審查，確保無邏輯漏洞或預留後門。 供應鏈組件審查： 針對關鍵零組件（如控制 IC）實施供應商評估與進料檢驗（IQC），防止假冒組件或被惡意竄改的硬體進入生產流程。 2. 已識別風險的流程（包括政策、矯正措施）。 變更管理與發布流程：依據 ISO 13485 標準，韌體更新需經過驗證機制，防止未經授權的竄改。 事件回應與召回機制：若發現潛在韌體漏洞或供應鏈安全疑慮，將啟動產品安全事件回應流程，評估風險等級，必要時透過實體維修服務或產品召回（Recall）進行韌體修補或硬體更換。 3. 與資料安全風險相關的財務後果（如補救成本、商譽風險）。 由於產品不儲存病患個資且不連網，無資料外洩之直接財務賠償風險，主要財務影響集中於： 產品召回與維修成本：若發生韌體安全漏洞導致顯示異常（可能影響醫療診斷），需進行大規模實體召回或現場更新，將產生高額物流與人力成本。 商譽與合規風險：作為醫療器材供應商，若發生安全漏洞可能導致客戶信任度下降，甚至影響FDA等醫療器材認證資格，進而衝擊訂單營收。

2.員工多元與共融

2.1 高階管理階層、非高階管理階層、專業人員及所有其他員工之性別及多元群體之代表性之百分比	員工多元化統計 一、性別比例 高階管理階層共6人，其中女性1人（0.7%）、男性5人（3.6%），無未揭露性別者。 非高階管理階層共14人，其中女性2人（1.5%）、男性12人（8.7%），無未揭露性別者。 技術人員共35人，其中女性9人（6.5%）、男性26人（18.9%），無未揭露性別者。 所有其他員工共83人，

	其中女性49人（35.5%）、男性34人（24.6%），無未揭露性別者。 二、多元群體比例 高階管理階層、非高階管理階層及技術人員中，原住民、新住民及身心障礙者人數均為0，比率皆為0%。 所有其他員工中，原住民1人（0.7%）、新住民3人（2.2%）、身心障礙者1人（0.7%）。

3.產品生命週期管理

3.1 含有IEC 62474應申報物質之產品收入百分比(%)	-
3.2 備註	暫無含有 IEC 62474 可申報物質的產品，故不適用本指標。
3.3 符合電子產品環境評估工具(EPEAT)註冊之規定或同等規範之資格產品收入百分比(%)	-
3.4 備註	暫無符合申請 EPEAT 或同等要求的產品，故不適用本指標。
3.5 獲得能源效率認證之資格產品收入百分比(%)	0
3.6 生命終結之產品及電子廢棄物回收之重量(公噸(t))	0
3.7 再循環之百分比(%)	0
3.8 備註	因 ODM 為賣斷機制，爰未有回收情形，相關數據為 0 噸；0%。

4.供應鏈管理

4.1 經責任商業聯盟有效性查核程序(VAP)或同等程序查核之一階供應商場所之百分比，按所有場所及高風險場所	尚未統計相關數據，預計後續規劃進行。

4.2 對於責任商業聯盟有效性查核程序（VAP）或同等程序，就一階供應商場所之優先不合格及其他不合格之不合格比率及相關改正行動比率	尚未統計相關數據，預計後續規劃進行。

5.材料取得

5.1 與關鍵材料之使用有關之風險管理之描述	1. 識別出對營運有重大風險的關鍵材料。 上述範例的元素廣泛使用於現代科技時代的各項產品，台灣電子資訊業因為位於全球半導體與電子供應鏈核心，屬於「高度受影響國家」。 本公司產品所使用的LCD液晶面板、OLED面板、觸控面板及電路板上所使用的各式 IC及半導體元件均受到一定程度的影響。 2. 面臨的風險類型 （如價格波動、供應限制、地緣政治、聲譽風險）。 尖端原料供應鏈集中度高，限制出口或全球短缺通常造成價格上漲與波動。 原料供應收緊可能造成交期延長、成本上升，甚至於短中期供貨中斷，以致公司無法如期出貨，面臨營收下降，聲譽受損及面對客戶違約求償的風險；若出口限制升級或政治緊張加劇，公司面臨供應鏈重構與替代來源尋找及驗證的成本，時效等多重壓力下，可能影響公司的競爭力。 3. 緩解策略（如供應商多元化、庫存囤積、替代材料研發、回收技術投資）。 建立長期供應合約與策略原料庫存備料做緩衝； 供應商多元化，建立替代性元件的尋找及可行性評估方案。

6.活動指標

6.1 生產單位數量，按產品類別劃分	1. 零組件5,482個 2. 電腦硬體70,288個
6.2 製造場所之面積(平方公尺(m2))	4086
6.3 自有場所產量之百分比(%)	99.80